

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2002289482 A

(43) Date of publication of application: 04.10.02

(51) Int. Cl

H01G 9/10

H01G 9/035

H01G 9/08

(21) Application number: 2001362226

(22) Date of filing: 28.11.01

(30) Priority: 17.01.01 JP 2001008491

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(72) Inventor:

MINATO KOICHIRO
KURIMOTO HIROSHI
YAMANE JUNJI

(54) ELECTRONIC COMPONENT

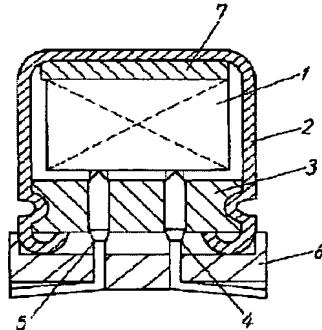
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electronic component wherein a sealing body is excellent in airtightness, little electrolyte for driving is emitted, and reliability is enhanced.

SOLUTION: The electronic component is provided with a metal case 2 for housing a capacitor element 1 impregnated with an electrolyte for driving and the sealing body 3 for sealing the opening of the metal case 2. The sealing body 3 is formed by mixing an additive containing phenols and derivatives thereof and a silane additive in butyl rubber as a main ingredient and cross-linking the mixture. Thus the reliable electronic component excellent in the hermeticity of the sealing body 3 is obtained.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO

- 1 コンデンサ素子
- 2 金属ケース
- 3 封口体
- 4 陽極リード線
- 5 陰極リード線
- 6 座板
- 7 絶縁紙



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号
特開2002-289482
(P2002-289482A)

(43)公開日 平成14年10月4日 (2002.10.4)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	マーク〇(参考)
H 01 G 9/10		H 01 G 9/10	E
9/035		9/08	F
9/08		9/02	3 1 1

審査請求 未請求 請求項の数9 O.L (全8頁)

(21)出願番号 特願2001-362226(P2001-362226)
(22)出願日 平成13年11月28日 (2001.11.28)
(31)優先権主張番号 特願2001-8491(P2001-8491)
(32)優先日 平成13年1月17日 (2001.1.17)
(33)優先権主張国 日本 (JP)

(71)出願人 000005821
松下電器産業株式会社
大阪府門真市大字門真1006番地
(72)発明者 売 浩一郎
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内
(72)発明者 栗本 浩
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内
(74)代理人 100097445
弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

最終頁に続く

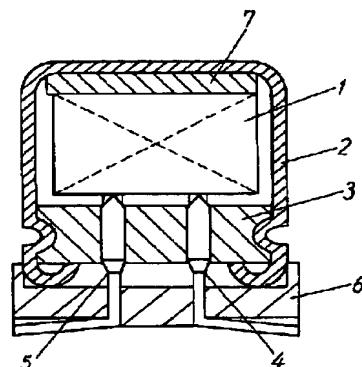
(54)【発明の名称】 電子部品

(57)【要約】

【課題】 封口体の気密性に優れ、駆動用電解液の揮散が少ない信頼性に優れた電子部品を提供することを目的とする。

【解決手段】 駆動用電解液を含浸させたコンデンサ素子1を収納する金属ケース2と、この金属ケース2の開口部を封止する封口体3からなり、上記封口体3がブチルゴムを主成分とし、これにフェノール類およびその誘導体を含む添加剤とシラン系添加剤を配合して架橋した構成とすることにより、封口体3の気密性に優れた高信頼性の電子部品を得ることができる。

- 1 コンデンサ素子
- 2 金属ケース
- 3 封口体
- 4 陽極リード線
- 5 陰極リード線
- 6 座板
- 7 絶縁紙



【特許請求の範囲】

【請求項1】 駆動用電解液が含浸された電子部品素子を収納する有底筒状の金属ケースと、この金属ケースの開口部を封口する弾性を有した封口体からなる電子部品において、上記封口体がブチルゴムを主成分とし、これにフェノール類およびその誘導体とシラン系添加剤を配合し、これを架橋して構成されたものである電子部品。

【請求項2】 フェノール類がフェノールのo, m, p位にアルキル基、水酸基、スルフヒドリル基を有するものであり、フェノールの誘導体が上記フェノール類が炭素、硫黄、アルキル基のいずれかにより2量化または3量化したものであり、シラン系添加剤が有機珪素化合物単量体の珪素に炭素、窒素、酸素、硫黄、水素のいずれか1種以上からなる有機酸と、炭素、水素、塩素のいずれか1種以上からなる加水分解基を有するものである請求項1に記載の電子部品。

【請求項3】 主成分であるブチルゴムのポリマー100重量部に対してフェノール類およびその誘導体を含む添加剤を0.5重量部以上配合して成形された封口体を用いた請求項1に記載の電子部品。

【請求項4】 主成分であるブチルゴムのポリマー100重量部に対してシラン系添加剤を0.1重量部以上配合して成形された封口体を用いた請求項1に記載の電子部品。

【請求項5】 駆動用電解液がエチレングリコール、 γ -ブチロラクトン、水の1つ以上から選ばれる溶液を用い、これに有機酸または無機酸、もしくは有機酸または無機酸のアンモニウム塩または第1級～第4級アンモニウム塩およびイミダゾリウム塩のいずれか1つ以上から選ばれる電解質塩を加えたものにより構成されたものである請求項1に記載の電子部品。

【請求項6】 封口体のブチルゴムを過酸化物または樹脂で架橋した請求項1に記載の電子部品。

【請求項7】 封口体のブチルゴムのリフローピーク温度での弾性率が4N/mm²以上である請求項1に記載の電子部品。

【請求項8】 電子部品がアルミ電解コンデンサである請求項1に記載の電子部品。

【請求項9】 アルミ電解コンデンサが、表面を粗面化した後に電解酸化により酸化皮膜が形成されたアルミニウム箔を陽極箔とし、この陽極箔と陰極箔をその間にセパレータを介在させて巻回することにより構成されたコンデンサ素子と、このコンデンサ素子の底面部に電解紙を介在させて駆動用電解液と共に収納する金属ケースと、上記コンデンサ素子から夫々引き出された陽極リード線と陰極リード線を貫通孔に貫通させた封口体を金属ケースの開口部に挿入して封止したものである請求項8に記載の電子部品。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は各種電子機器に利用される電子部品に関し、特に駆動用電解液が含浸された電子部品素子を収納した金属ケースの開口部を封止するための弾性を有した封口体の気密性向上を図った高信頼性の電子部品に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 この種の従来の電子部品について、アルミ電解コンデンサを例にして以下に説明する。図2は従来のアルミ電解コンデンサの構成を示した断面図であり、同図において、11はコンデンサ素子、12はこのコンデンサ素子11を図示しない駆動用電解液と共に収納する金属ケース、13はこの金属ケース12の開口部を封止する弾性を有した封口体、14と15は上記コンデンサ素子11から夫々引き出された陽極リード線と陰極リード線である。

【0003】 このように構成された従来のアルミ電解コンデンサでは、上記コンデンサ素子11に含浸された図示しない駆動用電解液として、エチレングリコールを主溶媒とし、これに有機酸のアンモニウム塩を加えたものが多く使用され、また、封口体13としては、スチレンブタジエンゴム、エチレンプロピレンゴムからなるものが多く使用されていた。

【0004】 更に、近年、広温度範囲に亘る信頼性が要求されるようになり、上記駆動用電解液の溶媒もエチレングリコールに代わって γ -ブチロラクトンが使用されるようになってきており、これに伴って従来の電解質成分である有機酸のアンモニウム塩では駆動用電解液の電気伝導度が低いため、一般的には有機酸の第4級アンモニウム塩が使用されるようになってきている。

【0005】 また、これらの駆動用電解液の変更により、上記封口体13も気密性の高いイソブチレン・イソブレンゴム、いわゆるブチルゴムが使用されるようになってきている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら上記従来のアルミ電解コンデンサでは、これらの気密性に優れたブチルゴムからなる封口体13と有機酸の第4級アンモニウム塩を電解質とする駆動用電解液とを組み合わせてアルミ電解コンデンサを作製し、これを高温での寿命試験または高温高湿条件下での寿命試験を行うと、上記駆動用電解液が封口体13に悪影響を及ぼし、その結果、封口体13の気密性が低下して金属ケース12の内部にコンデンサ素子11と共に収納された駆動用電解液が揮散するという課題があった。

【0007】 本発明はこのような従来の課題を解決し、封口体の気密性が低下しない優れた信頼性の電子部品を提供することを目的とするものである。

【0008】

【課題を解決するための手段】 上記課題を解決するため50に本発明の請求項1に記載の発明は、特に、ブチルゴム

にフェノール類およびその誘導体とシラン系添加剤を配合し、これを架橋して構成した封口体を用いた構成としたものであり、これにより、高温での寿命試験または高温高湿条件下での寿命試験においても封口体が駆動用電解液の悪影響を受けることがなく、封口体の気密性の低下を抑制して信頼性に優れた電子部品を実現することができるという作用効果が得られる。

【0009】請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、フェノール類がフェノールのo, m, p位にアルキル基、水酸基、スルフヒドリル基を有するものであり、フェノールの誘導体が上記フェノール類が炭素、硫黄、アルキル基のいずれかにより2量化または3量化したものであり、シラン系添加剤が有機珪素化合物単量体の珪素に炭素、窒素、酸素、硫黄、水素のいずれか1種以上からなる有機酸と、炭素、水素、塩素のいずれか1種以上からなる加水分解基を有するものであり、請求項1に記載の発明により得られる作用効果をより効率よく引き出すことができるという作用効果が得られる。

【0010】請求項3に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、特に、フェノール類およびその誘導体を含む添加剤の添加量を、ブチルゴムのポリマー100重量部に対して0.5重量部以上としたものであり、これにより、請求項1に記載の発明により得られる作用効果をより効率良く引き出すことができるという作用効果が得られる。なお、上記添加量が0.5重量部未満では本発明による効果を十分に發揮することができないので好ましくない。

【0011】請求項4に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、特に、シラン系添加剤の添加量を、ブチルゴムのポリマー100重量部に対して0.1重量部以上としたものであり、これにより、請求項1に記載の発明により得られる作用効果をより効率良く引き出すことができるという作用効果が得られる。なお、上記添加量が0.1重量部未満では本発明による効果を十分に發揮することができないので好ましくない。

【0012】請求項5に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、駆動用電解液がエチレングリコール、 γ -ブチロラクトン、水の1つ以上から選ばれる溶液を用い、これに有機酸または無機酸、もしくは有機酸または無機酸のアンモニウム塩または第1級～第4級アンモニウム塩およびイミダゾリウム塩のいずれか1つ以上から選ばれる電解質塩を加えたものにより構成されたものであり、これにより、封口体との組み合わせによって悪影響を与えることが無くなり、高温での寿命試験または高温高湿条件下での寿命試験においても、封口体の気密性の低下を抑制して信頼性に優れた電子部品を実現することができるという作用効果が得られる。

【0013】請求項6に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、封口体の架橋構造が過酸化物または樹

脂により架橋された構成としたものであり、これにより、請求項1に記載の発明により得られる作用効果をより効率良く引き出すことができるという作用効果が得られる。

【0014】請求項7に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、封口体のブチルゴムのリフローピーク温度での弾性率が4 N/mm²以上とした構成であり、これにより、請求項1に記載の発明により得られる作用効果をより効率良く引き出すことができるという作用効果が得られる。なお、上記リフローピーク温度とは、リフローにおける最高温度のことを言う。

【0015】請求項8に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、電子部品がアルミ電解コンデンサである構成としたものであり、これにより、請求項1～7のいずれかに記載の発明により得られる作用効果をより効果的に得ることができるという作用効果が得られる。

【0016】請求項9に記載の発明は、請求項8に記載の発明において、アルミ電解コンデンサが、表面を粗面化した後に電解酸化により酸化皮膜が形成されたアルミニウム箔を陽極箔とし、この陽極箔と陰極箔をその間にセパレータを介在させて巻回することにより構成されたコンデンサ素子と、このコンデンサ素子の底面部に電解紙を介在させて駆動用電解液と共に収納する金属ケースと、上記コンデンサ素子から夫々引き出された陽極リード線と陰極リード線を貫通孔に貫通させた封口体を金属ケースの開口部に挿入して封止した構成であり、封口体が駆動用電解液の悪影響を受けることがなく、また、陽極箔および陰極箔と金属ケースとの接触によるショート不良を低減できるので、高温での寿命試験または高温高湿条件下での寿命試験の信頼性に優れたアルミ電解コンデンサを実現することができるという作用効果が得られる。

【0017】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を用いて、本発明の請求項1～9に記載の発明について説明する。

【0018】図1は本発明の実施の形態（比較例および従来例も兼ねる）による電子部品としてのアルミ電解コンデンサの構成を示した断面図であり、同図1において、1は電子部品素子としてのコンデンサ素子であり、このコンデンサ素子1は、表面を粗面化した後に電解酸化により酸化皮膜が形成されたアルミニウム電極箔を陽極箔とし、この陽極箔と陰極箔をその間にセパレータを介在させて巻回することにより構成されている。

【0019】2はこのコンデンサ素子1を図示しない駆動用電解液と共に収納する金属ケースで、コンデンサ素子1と金属ケース2の間に絶縁紙7を介在させている。3はこの金属ケース2の開口部を封止する弹性を有した封口体、4と5は上記コンデンサ素子1から夫々引き出された陽極リード線と陰極リード線であり、上記封口体

3には陽極リード線4と陰極リード線5が貫通する貫通孔が設けられ、この貫通孔に両リード線4, 5を貫通して封口体3を金属ケース2の開口部に挿入した後、金属ケース2の開口部を内側に折り曲げて封口体3を押圧し、更に、金属ケース2の周囲を絞り加工することにより封口体3の有する弾性を利用することにより封止しその後、外部に引き出された両リード線4, 5を座板6の貫通孔に通し、両リード線4, 5の引き出された部分を偏平加工し座板6にそって折り曲げて構成しているものである。

【0020】以下、具体的な実施例について説明する。

【0021】(実施例1) 駆動用電解液として、 γ -ブチロラクトンを溶媒とし、4級アンモニウム塩を溶質として構成したものを用いた。封口体として、ブチルゴムを主成分とし、これにブチルゴムのポリマー100重量部に対してフェノール類およびその誘導体を含む添加剤を0.5重量部と、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してシラン系添加剤を0.1重量部配合して樹脂架橋することにより封口体を構成した以外は実施例1と同様にしてアルミ電解コンデンサを作製した。

【0022】なお、上記フェノール類とは、フェノールのo, m, p位にアルキル基、水酸基、スルフィドリル基を有するもので、その誘導体は上記フェノール類が炭素または硫黄またはアルキル基等により2量化、3量化したものである。

【0023】また、シラン系添加剤とは、有機珪素化合物単量体で、珪素に炭素、窒素、酸素、硫黄、水素のいずれか1種以上からなる有機酸と、炭素、水素、塩素のいずれか1つ以上からなる加水分解基を有するものである。

【0024】(実施例2) 上記実施例1において、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してフェノール類およびその誘導体を含む添加剤を0.8重量部と、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してシラン系添加剤を0.1重量部配合して樹脂架橋することにより封口体を構成した以外は実施例1と同様にしてアルミ電解コンデンサを作製した。

【0025】(実施例3) 上記実施例1において、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してフェノール類およびその誘導体を含む添加剤を1.0重量部と、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してシラン系添加剤を0.1重量部配合して樹脂架橋することにより封口体を構成した以外は実施例1と同様にしてアルミ電解コンデンサを作製した。

【0026】(実施例4) 上記実施例1において、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してフェノール類およびその誘導体を含む添加剤を5.0重量部と、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してシラン系添加剤を0.1重量部配合して樹脂架橋することにより封口体を構成した以外は実施例1と同様にしてアルミ電解コン

デンサを作製した。

【0027】(実施例5) 上記実施例1において、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してフェノール類およびその誘導体を含む添加剤を10.0重量部と、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してシラン系添加剤を0.1重量部配合して樹脂架橋することにより封口体を構成した以外は実施例1と同様にしてアルミ電解コンデンサを作製した。

【0028】(実施例6) 上記実施例1において、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してフェノール類およびその誘導体を含む添加剤を0.5重量部と、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してシラン系添加剤を0.3重量部配合して樹脂架橋することにより封口体を構成した以外は実施例1と同様にしてアルミ電解コンデンサを作製した。

【0029】(実施例7) 上記実施例1において、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してフェノール類およびその誘導体を含む添加剤を0.5重量部と、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してシラン系添加剤を0.5重量部配合して樹脂架橋することにより封口体を構成した以外は実施例1と同様にしてアルミ電解コンデンサを作製した。

【0030】(実施例8) 上記実施例1において、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してフェノール類およびその誘導体を含む添加剤を0.5重量部と、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してシラン系添加剤を1.0重量部配合して樹脂架橋することにより封口体を構成した以外は実施例1と同様にしてアルミ電解コンデンサを作製した。

【0031】(実施例9) 上記実施例1において、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してフェノール類およびその誘導体を含む添加剤を0.5重量部と、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してシラン系添加剤を5.0重量部配合して樹脂架橋することにより封口体を構成した以外は実施例1と同様にしてアルミ電解コンデンサを作製した。

【0032】(実施例10) 上記実施例1において、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してフェノール類およびその誘導体を含む添加剤を0.5重量部と、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してシラン系添加剤を10.0重量部配合して樹脂架橋することにより封口体を構成した以外は実施例1と同様にしてアルミ電解コンデンサを作製した。

【0033】(実施例11) 上記実施例1において、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してフェノール類およびその誘導体を含む添加剤を0.3重量部と、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してシラン系添加剤を0.1重量部配合して樹脂架橋することにより封口体を構成した以外は実施例1と同様にしてアルミ電解コンデンサを作製した。

【0034】(実施例12) 上記実施例1において、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してフェノール類およびその誘導体を含む添加剤を0.5重量部と、ブチルゴムのポリマー100重量部に対してシラン系添加剤を0.05重量部配合して樹脂架橋することにより封口体を構成した以外は実施例1と同様にしてアルミ電解コンデンサを作製した。

【0035】(比較例) 上記実施例1において、フェノール類およびその誘導体を含む添加剤とシラン系添加剤を配合しないでブチルゴムのポリマーを樹脂架橋することにより封口体を構成した以外は実施例1と同様にして*

高温試験：試験温度105°Cによる封口体の気密性測定結果

表中の分母は試験数、分子は気密性不具合の発生数を示す。

	フェノール類 およびその誘 導体の添加量	シラン系添加剤の 添加量	1000 時間	2000 時間	3000 時間	5000 時間
実施例1	0.5重量部	0.1重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例2	0.8重量部	0.1重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例3	1.0重量部	0.1重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例4	5.0重量部	0.1重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例5	10.0重量部	0.1重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例6	0.5重量部	0.3重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例7	0.5重量部	0.5重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例8	0.5重量部	1.0重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例9	0.5重量部	5.0重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例10	0.5重量部	10.0重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例11	0.3重量部	0.1重量部	0/20	0/20	6/20	12/20
実施例12	0.5重量部	0.05重量部	0/20	0/20	5/20	13/20
比較例	0重量部	0重量部	0/20	3/20	12/20	17/20

【0038】

【表2】

高温高湿試験：試験温度 85°C 相対湿度 85%による封口体の気密性測定結果

表中の分母は試験数、分子は気密性不具合の発生数を示す。

	フェノール類 およびその誘 導体の添加量	シラン系添加剤の 添加量	1000 時間	2000 時間	3000 時間	5000 時間
実施例 1	0. 5 重量部	0. 1 重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例 2	0. 8 重量部	0. 1 重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例 3	1. 0 重量部	0. 1 重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例 4	5. 0 重量部	0. 1 重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例 5	10. 0 重量部	0. 1 重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例 6	0. 5 重量部	0. 3 重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例 7	0. 5 重量部	0. 5 重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例 8	0. 5 重量部	1. 0 重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例 9	0. 5 重量部	5. 0 重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例 10	0. 5 重量部	10. 0 重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例 11	0. 3 重量部	0. 1 重量部	0/20	2/20	12/20	18/20
実施例 12	0. 5 重量部	0. 05 重量部	0/20	3/20	13/20	17/20
比較例	0 重量部	0 重量部	0/20	8/20	18/20	20/20

【0039】

【表3】
鉛を使用しない半田を使用したリフロー試験結果

表中の分母は試験数、分子は実装不具合の発生数を示す。

	フェノール類 およびその誘 導体の添加量	シラン系添加剤の 添加量	ピーク 温度 240°C	ピーク 温度 250°C	ピーク 温度 260°C	ピーク 温度 270°C
実施例 1	0. 5 重量部	0. 1 重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例 2	0. 8 重量部	0. 1 重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例 3	1. 0 重量部	0. 1 重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例 4	5. 0 重量部	0. 1 重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例 5	10. 0 重量部	0. 1 重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例 6	0. 5 重量部	0. 3 重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例 7	0. 5 重量部	0. 5 重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例 8	0. 5 重量部	1. 0 重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例 9	0. 5 重量部	5. 0 重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例 10	0. 5 重量部	10. 0 重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例 11	0. 3 重量部	0. 1 重量部	0/20	0/20	0/20	0/20
実施例 12	0. 5 重量部	0. 05 重量部	0/20	0/20	5/20	20/20
比較例	0 重量部	0 重量部	0/20	5/20	15/20	20/20

【0040】

【表4】

封口体に使用したゴム材料高温弹性率試験結果

表中数値は弾性率 (N/mm²) を示す

	フェノール類 およびその誘 導体の添加量	シラン系添加剤の 添加量	試験 温度 240°C	試験 温度 250°C	試験 温度 260°C	試験 温度 270°C
実施例 1	0.5 重量部	0.1 重量部	4.60	4.40	4.20	4.10
実施例 2	0.8 重量部	0.1 重量部	4.60	4.40	4.20	4.10
実施例 3	1.0 重量部	0.1 重量部	4.60	4.40	4.20	4.10
実施例 4	5.0 重量部	0.1 重量部	4.55	4.35	4.15	4.05
実施例 5	10.0 重量部	0.1 重量部	4.60	4.40	4.20	4.10
実施例 6	0.5 重量部	0.3 重量部	4.80	4.65	4.45	4.30
実施例 7	0.5 重量部	0.5 重量部	4.90	4.75	4.50	4.35
実施例 8	0.5 重量部	1.0 重量部	5.20	5.00	4.85	4.65
実施例 9	0.5 重量部	5.0 重量部	5.50	5.30	5.00	4.85
実施例 10	0.5 重量部	10.0 重量部	6.00	5.85	5.60	5.20
実施例 11	0.3 重量部	0.1 重量部	4.60	4.40	4.20	4.10
実施例 12	0.5 重量部	0.05 重量部	4.30	4.15	3.90	3.75
比較例	0 重量部	0 重量部	4.20	3.90	3.80	3.70

【0041】以上の(表1)、(表2)の結果から明らかなように、封口体にシラン系添加剤を配合することにより封止応力、耐湿性を確保し、フェノール類およびその誘導体を配合することにより劣化を抑制し、封止応力を維持する効果が得られ、これらにより気密性の低下を抑制して駆動用電解液の揮散を無くし、(表3)、(表4)の結果から明らかなように、シラン系添加剤を配合することにより、高温での弾性率を確保しリフローでの実装不良のない信頼性に優れたアルミ電解コンデンサまたは電子部品を提供することができるものである。

【0042】なお、上記フェノール類およびその誘導体の添加量はブチルゴムのポリマー100重量部に対して0.5重量部以上必要であり、これ未満ではその結果を充分に發揮することができないものである。

【0043】また、上記シラン系添加剤の添加量はブチルゴムのポリマー100重量部に対して0.1重量部以上必要であり、これ未満ではその結果を充分に発揮することができないものである。

【0044】また、コンデンサ素子と金属ケースの間に絶縁紙を介在させることにより、高温試験および高温高湿試験において、全くショート不良の問題は起きなかつた。

【0045】この絶縁紙としては、マニラ麻やクラフト紙などいわゆる電解紙といわれるもの、ポリエチレン樹

脂などの有機樹脂の不織布、ガラス纖維不織布などを用いることができる。

【0046】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、ブチルゴムにフェノール類およびその誘導体とシラン系添加剤を配合し、これを架橋して構成した封口体を用いた構成とすることにより、高温での寿命試験または高温高湿条件下での寿命試験においても封口体が駆動用電解液の悪影響を受けることがなく、封口体の気密性の低下を抑制して信頼性に優れた電子部品を提供することができるものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態のアルミ電解コンデンサの構成を示す断面図

【図2】従来のアルミ電解コンデンサの構成を示す断面図

【符号の説明】

- 1 コンデンサ素子
- 2 金属ケース
- 3 封口体
- 4 陽極リード線
- 5 陰極リード線
- 6 座板
- 7 絶縁紙

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

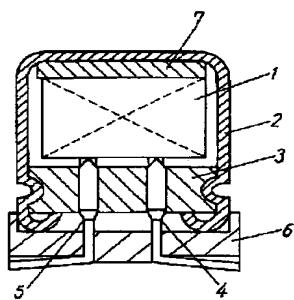
263

264

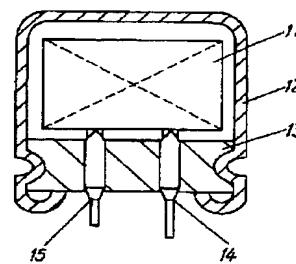
265

【図1】

- 1 コンデンサ素子
- 2 金属ケース
- 3 封口体
- 4 陽極リード線
- 5 薄極リード線
- 6 座板
- 7 絶縁紙



【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 山根 淳二

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.